

浙江晶盛机电股份有限公司 关于改变部分募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议审议通过了《关于改变部分募集资金用途的议案》，董事会同意公司根据实际情况将“12英寸集成电路大硅片设备测试实验线项目”的募集资金投资总额调整为17,800.00万元，并将剩余募集资金及已终止的“年产80台套半导体材料抛光及减薄设备生产制造项目”剩余募集资金合计86,141.00万元（含利息及理财收益）投资于新项目“半导体装备精密零部件智能化生产项目”和“高端半导体设备碳化硅零部件产业化项目”。本次改变募集资金用途事项尚需提交公司股东会审议。公司将在股东会审议通过后，以募集资金向全资子公司（实施主体）增资，并与子公司及其募集资金开户银行、保荐机构签署募集资金四方监管协议。现将具体事项公告如下：

一、改变募集资金投资项目情况概述

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江晶盛机电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕947号），并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用向特定对象发行的方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票21,353,383股，发行价为每股人民币66.50元，共计募集资金142,000.00万元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于2022年7月15日汇入本公司募集资金监管账户。另减除承销保荐费、验资费、律师费等与发行权益性证券直接相关的外部费用397.30万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为141,602.70万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊

普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2022〕360号)。

募集资金到账后,公司对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、募集资金开户行签署了《募集资金三方监管协议》。

(二) 募集资金使用情况

根据公司《向特定对象发行股票募集说明书》披露的募集资金用途,本次募投项目及截至 2025 年 12 月 31 日募集资金使用情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	承诺投入募集资金	累计投入募集资金	投资进度
1	12 英寸集成电路大硅片设备测试实验线项目	56,370.00	8,597.14	15.25%
2	年产 80 台套半导体材料抛光及减薄设备生产制造项目	43,210.00	2,956.46	已终止
3	补充流动资金	42,022.70	42,229.81	100.49%
	合计	141,602.70	53,783.41	-

公司 2025 年 6 月 27 日召开第五届董事会第二十次会议及 2025 年 7 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》。同意公司根据实际情况终止向特定对象发行股票募集资金投资项目“年产 80 台套半导体材料抛光及减薄设备生产制造项目”,并将剩余募集资金继续存放公司募集资金专用账户管理。

(三) 改变募集资金投资项目情况

公司拟将 12 英寸集成电路大硅片设备测试实验线项目的募集资金投资金额调整为 17,800.00 万元,并将该项目剩余募集资金及已终止项目“年产 80 台套半导体材料抛光及减薄设备生产制造项目”剩余募集资金共计 86,141.00 万元(含利息及理财收益)投资于新项目“半导体装备精密零部件智能化生产项目”和“高端半导体设备碳化硅零部件产业化项目”,本次改变募集资金用途后,公司募集资金投资项目情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	调整前承诺投入募集资金	调整后承诺投入募集资金	备注
1	12 英寸集成电路大硅片设备测试实验线项目	56,370.00	17,800.00	调整投资额

2	年产 80 台套半导体材料抛光及减薄设备生产制造项目	43,210.00	2,956.46	已终止
3	半导体装备精密零部件智能化生产项目	-	66,131.00	新项目
4	高端半导体设备碳化硅零部件产业化项目	-	20,010.00	新项目
5	补充流动资金	42,022.70	42,022.70	
合计		141,602.70	148,920.16	

二、改变募投项目的原因

1、原募投项目计划和实际投资情况

公司“12英寸集成电路大硅片设备测试实验线项目”为研发项目，总投资75,000.00万元，其中拟投入募集资金56,370.00万元，募集资金投入项目主要用于装修工程和设备购置及安装，拟建设涵盖半导体12英寸集成电路大硅片长晶、滚磨、截断、切片、倒角、研磨、减薄、抛光工序的设备测试线。截至2025年12月31日，已使用募集资金8,597.14万元，主要为洁净室装修及设备投入。

2、本次调整募投项目投资额的原因

公司“12英寸集成电路大硅片设备测试实验线项目”建设规划装修工程建设投入12,825.00万元，包括洁净室、空调及纯水系统等；设备投资43,545.00万元，主要涵盖半导体12英寸集成电路大硅片长晶、滚磨、截断、切片、倒角、研磨、减薄、抛光工序的设备及相关量检测设备，以满足测试实验需求。近年来，随着人工智能、高性能计算、5G、汽车和工业应用等领域的持续发展，半导体行业景气度持续提升，半导体集成电路设备国产化进程持续加快，相关国产设备性能持续提升，已达到国际先进水平。公司在半导体集成电路装备的硅片材料装备领域，依托多年的技术和工艺积累，率先实现了8-12英寸半导体大硅片设备的国产替代，长晶、滚磨、研磨、减薄、抛光等工序设备均实现国内头部客户的批量销售，相关产品性能及核心参数指标达到国际先进水平。

在项目实施建设过程中，国内半导体产业链逐步完善，国产半导体装备零部件性能持续提升，公司设备供应链逐步实现国产化，伴随着规模的提升，相关设备制造成本较之前有所下降，公司出于节省成本考虑，将投入建设的自产设备以成本结转，相较项目规划时的市场价格大幅降低。另外，随着国产检测设备性能持续提升，在满足项目建设技术需求的前提下，公司计划将部分进口的检测设备

改为采购国产设备，将进一步节省项目的设备投入成本。

本项目将以完备的检测设备和先进、高标准、高质量的测试场地为基础，覆盖多场景、多工序、不同指标的试验检测能力，积极追踪和运用半导体新技术，满足改善公司测试条件，提升产品研发和测试能力，进一步培育研发及工艺人才，加速科技成果的转化，提升公司在 12 英寸集成电路大硅片设备和相关辅料、耗材及核心零部件的实验和测试能力，加强产业链上下游联合创新，促进半导体大硅片设备和辅材、耗材、零部件的国产化进程。本次项目投资额度调整，是基于国内半导体产业链发展的实际情况做出的审慎决策，通过国产化的技术创新，在不改变项目预期效果的同时，大幅节省项目投入成本。

三、新募投项目情况说明

（一）半导体装备精密零部件智能化生产项目

1、项目基本情况和投资计划

公司半导体装备精密零部件智能化生产项目预计总投资 66,831.00 万元，其中建设投资 66,131.00 万元，流动资金 700.00 万元。由公司及全资子公司浙江晶鸿精密机械制造有限公司（以下简称“晶鸿精密”）共同实施。本项目将在绍兴市上虞区通江西路 218 号原有厂房及五星西路 218 号公司新购置土地建设厂房实施。本项目拟购置 74.2 亩土地，建设 1 栋生产车间及辅助用房，同时改造利用现有车间，购置一批国内外先进零部件加工和检测等设备，形成年产 1,410 套半导体装备精密零部件的产能（含框架类、腔体类、结构件类及超精密类零件）。具体投资计划如下：

序号	投资内容	投资金额（万元）	募集资金金额（万元）
1	土地购置费	2,000.00	2,000.00
2	土建工程	12,798.00	12,798.00
3	装修工程	7,956.00	7,956.00
4	设备购置及安装费	43,377.00	43,377.00
5	铺底流动资金	700.00	-
	合计	66,831.00	66,131.00

2、项目可行性分析

（1）项目的背景情况

近年来，随着人工智能、物联网、6G、自动驾驶等新兴技术的持续发展，带动半导体行业稳步增长。全球晶圆厂资本性开支持续提升，促使半导体设备需求旺盛。零部件作为半导体设备产业链的基石，设备端的景气热度顺势传导至上游零部件环节，使其需求显著增加。我国半导体产业链自主可控以及高端装备国产化，对高精度、高可靠性零部件的需求呈指数级增长。同时，行业在产品质量、生产效率、成本控制等方面的升级需求，正倒逼半导体供应链加速国产化、高端化转型。

根据 QYResearch 数据，2025 年全球半导体设备用零部件市场规模约为 463.18 亿美元，预计到 2032 年将增长至 756.77 亿美元，2026-2032 年期间的年复合增长率约为 6.9%，行业整体呈现持续上行态势。与此同时，晶圆厂对设备稼动率、工艺控制能力、真空系统稳定性、洁净流体管理以及在线监测能力的要求不断提升，也促进了高价值零部件在单台设备中的搭载量持续增加。半导体设备零部件行业已不再单纯依赖设备出货量的增长，而是进入了由“设备复杂度提升、单台设备价值量上升、供应链区域格局重构”共同驱动的发展新阶段。

当前，我国在半导体高端设备领域面临挑战，其中关键零部件的“卡脖子”问题较为突出，实现零部件的自主突破，对国内半导体设备的发展具有重大战略作用。首先，零部件是设备整机自主可控的关键，核心零部件的国产化是实现产业链自主可控、安全可靠和高质量发展的关键前提。其次，国内设备在追赶国际先进水平的过程中，当零部件实现本土化、高端化突破后，能提升整机性能，避免因单一指标落后而拉低整体水平。再次，本地化零部件可大幅缩短交付周期、降低综合成本。

本项目的实施将着力突破精密零部件的国产化，满足日益高涨的市场需求，显著提升国产高端零部件的自主保障能力，为国内设备厂商提供可靠的本地化配套支持，有助于突破核心零部件的供应链封锁，形成自主可控的国产化技术，助力国产半导体装备的性能提升和产业化进程，对保障国家信息产业安全、提升国际竞争力具有深远影响。

（2）投资项目的选址、拟占用土地的面积、取得方式及土地用途

本项目由公司及全资子公司晶鸿精密共同实施，公司将在绍兴市上虞区五星

西路 218 号购置 74.2 亩土地，建设 1 栋生产车间及辅助用房，同时使用位于绍兴市上虞区通江西路 218 号的原有厂房，厂房建筑面积共计 35,000 m²，由晶鸿精密对两处厂房进行装修及购置设备并实施运营。

3、项目经济效益分析

根据测算，本项目总投资 66,831.00 万元，建设期 2 年，建成达产后预计年增销售收入为 49,125.00 万元，年增净利润为 5,187.00 万元，财务内部收益率 11%（税后），投资回收期为 7.41 年，具备较强的可行性和盈利能力。

（二）高端半导体设备碳化硅零部件产业化项目

1、项目基本情况和投资计划

公司“高端半导体设备碳化硅零部件产业化项目”预计总投资 20,610.00 万元，其中建设投资约 20,010.00 万元，流动资金 600.00 万元。由全资子公司浙江晶诚新材料有限公司（以下简称“晶诚新材料”）实施，使用位于浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区舜园路 012 号厂房进行改造，购置一批先进的生产、检测及配套设备（包括 CNC 机加工设备、烧结炉、氧化炉、CVD 炉以及配套的清洗烘干设备和三坐标检测设备），形成年产碳化硅外延炉石墨腔体及配套耗材、硅外延炉石墨基座、碳化硅氧化炉专用炉管、刻蚀设备专用刻蚀环共计 20,350 套/件。具体投资计划如下：

序号	投资内容	投资金额（万元）	募集资金金额（万元）
1	厂房装修及改造	6,500.00	6,500.00
2	设备购置及安装费	13,510.00	13,510.00
3	铺底流动资金	600.00	-
合计		20,610.00	20,010.00

2、项目可行性分析

（1）项目的背景情况

近年来，全球半导体设备行业正迎来高景气周期，人工智能、AI 服务器、高性能计算以及新能源汽车等应用领域的持续发展，带动半导体产业链规模持续增长，半导体相关制造设备的市场需求持续提升。中国大陆作为全球最大半导体消费及设备市场，带动本土产业规模与技术水平稳步提升。根据 SEMI 数据，2025 年全球半导体专用设备市场规模达 1,351 亿美元，2021-2025 年复合增长率约

7.1%；同期中国大陆半导体专用设备市场规模达 493 亿美元，全球占比超 36%，2021-2025 年复合增长率高达 13.6%。全球半导体设备消费市场高度集中于亚洲，中国大陆已连续六年位居全球第一大半导体设备市场。

高端半导体设备用碳化硅零部件作为半导体设备关键核心零部件，是外延生长、刻蚀、薄膜沉积等核心工艺环节的关键部件，直接影响芯片制造的良率与性能。根据 QYResearch 数据，2025 年全球 CVD 碳化硅零部件市场规模达到 11.54 亿美元，预计 2032 年将达到 21.92 亿美元，2025-2032 年复合增长率为 9.7%。2025 年中国 CVD 碳化硅零部件市场规模达到 3.17 亿美元，预计 2032 年将达到 7.66 亿美元，2025-2032 年复合增长率为 13.44%。受益于第三代半导体、集成电路产线持续扩张及国产替代加速，我国 CVD 碳化硅零部件市场前景广阔。目前由于上游高纯石墨原料市场长期被海外头部企业垄断，国产化率偏低，导致目前高端半导体设备用碳化硅零部件仍依赖进口。

本项目的实施，一方面顺应了国家半导体的发展趋势，深度受益于国内集成电路产业的快速增长，可实现国产技术、产品的突破，满足市场日益增长的需求。另一方面符合公司“新材料、新装备”战略定位，同时完善公司在高端装备产业链中对半导体级碳化硅精密零部件特殊要求的配套能力，实现零部件及产品的全流程自主化生产，进一步提高公司在半导体领域的市场竞争力，进一步提升公司的盈利能力和核心竞争力。

（2）投资项目的选址、拟占用土地的面积、取得方式及土地用途

本项目由全资子公司晶诚新材料实施，使用位于浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区舜园路 012 号自有厂房进行改造，面积 14,000 m²。

3、项目经济效益分析

根据既定条件测算，本项目总投资 20,610.00 万元，建设期 2 年，建成达产后预计年增销售收入 24,716.00 万元，年增净利润 2,741.00 万元，税后财务内部收益率 14.87%，税后投资回收期为 4.96 年，具备较强的可行性和盈利能力。

（三）项目实施面临的风险及应对措施

1、市场竞争加剧风险

随着全球半导体行业的快速发展，对于半导体设备零部件的需求不断增加，吸引越来越多的市场参与者积极开展相关领域的投资，如果公司未来无法通过提

升研发实力、产品性能和客户拓展能力有效应对日益激烈的市场竞争，将导致公司产品的市场竞争力及产品价格下降，从而对公司的盈利能力产生不利影响。

公司在半导体精密零部件的关键制造环节具备技术及规模优势，尤其在精密机械制造、表面处理特种工艺、特种焊接等核心领域，形成了难以复制的技术壁垒，其中刻蚀、薄膜沉积等关键设备零部件已实现批量供货国内主流半导体设备企业，成为国产半导体设备厂商核心零部件国产化进程中的重要战略合作伙伴。未来将持续提升研发创新能力，强化加工制造优势，扩大客户群体，提升技术服务品质，以优质的产品和服务夯实综合竞争力。

2、项目实施及效益不达预期风险

本项目围绕公司主营业务进行，公司已对上述项目进行了全面、审慎的可行性研究及论证，但在项目实施过程中，仍可能因组织管理、建设统筹等因素导致项目建设进度滞后；项目投产后，若行业政策、市场供需及竞争格局发生重大不利变化，或市场拓展不及预期，可能造成项目产能利用率及投资收益不达预期的风险。

公司将建立专项项目管理机制，细化任务分工与进度管控，全程督导项目建设、安装调试及投产运营各环节，确保项目按计划推进落地。持续跟踪行业政策与市场动态，常态化开展市场形势研判，提前制定风险预案。加大市场渠道建设与优质客户拓展力度，深化战略合作，提升产品市场占有率与产能消化能力。同时优化生产运营与成本管控体系，持续改进工艺效率、严控运营成本，提升项目盈利韧性。公司亦将根据项目实际进展及外部市场变化，适时优化实施规划与经营策略，最大程度降低项目效益不达预期带来的不利影响。

四、本次改变募集资金用途对公司的影响

本次改变募集资金用途符合公司战略发展规划，可进一步增强公司产品配套能力与综合竞争力，符合公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不会对公司正常的生产经营和业务发展、公司财务状况和经营成果等产生重大不利影响。公司将严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保合法使用募集资金，以实现公司和股东利益最大化。

五、公司履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

2026年6月3日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于改变部分募集资金用途的议案》，同意公司调整“12英寸集成电路大硅片设备测试实验线项目”募集资金投资额度，并将剩余募集资金及已终止的“年产80台套半导体材料抛光及减薄设备生产制造项目”剩余募集资金合计86,141.00万元（含利息及理财收益）投资于新项目“半导体装备精密零部件智能化生产项目”和“高端半导体设备碳化硅零部件产业化项目”。本次改变募集资金用途事项尚需提交公司股东会审议。

（二）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司改变部分募集资金用途事项已经董事会审议通过，尚需提交股东会审议通过，公司已履行了现阶段必要的审批程序。本次改变部分募集资金用途事项，符合公司实际经营需要，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。保荐人对公司本次改变部分募集资金用途事项无异议。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第五次会议决议；
- 2、兴业证券股份有限公司出具的核查意见。

特此公告。

浙江晶盛机电股份有限公司

董事会

2026年6月4日